

EFEP 日本大金氟化工 RP-5000 半导体模制化合物 薄膜 多层薄膜 汽车领域的应用 管件

产品名称	EFEP 日本大金氟化工 RP-5000 半导体模制化合物 薄膜 多层薄膜 汽车领域的应用 管件
公司名称	深圳市福祿克科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	日本大金氟化:EFEP
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区张屋新村十三巷 1号1403-7 (注册地址)
联系电话	15814619446 15814619446

产品详情

EFEP RP-5000是一种含氟聚合物，它将ETFE的优异物理和化学性能与较低的加工温度结合在一起，更适合工程树脂和传统热塑性聚合物。这种树脂可以很好地附着在许多塑料和无机材料(玻璃、金属)上，而不需要粘合剂或钝刻。EFEP RP-5000可以很容易地共挤出多层管子或薄膜，在汽车石油和天然气、化学加工、半导体和薄膜工业的广泛应用中具有以下优点:非常好的抗碳氢化合物渗透性、优异的耐化学性、高纯度、改进的热老化弹性。与其他树脂(尼龙、EOH、改性PE和EJFE)共挤出，无粘合剂或钝刻，粘合强度高，耐候性好，耐冷冲击。